

股票简称：美利信

股票代码：301307



**重庆美利信科技股份有限公司**

**Chongqing Millison Technologies INC.**

(重庆市巴南区天安路 1 号附 1 号、附 2 号)

**向特定对象发行 A 股股票**

**募集资金使用可行性分析报告**

**二〇二五年十二月**

## 一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 120,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入
1	半导体装备精密结构件建设项目	55,509.61	50,000.00
2	通信及汽车零部件可钎焊压铸产业化项目	52,449.96	50,000.00
3	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00
合计		127,959.57	120,000.00

项目投资总额超出募集资金净额部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

若实际募集资金数额少于上述项目拟投入募集资金投资金额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的重要性、时效性等情况进行调整并最终决定募集资金的具体投资项目及各项目的投资金额。

## 二、本次募集资金投资项目的具体情况

### （一）半导体装备精密结构件建设项目

#### 1、项目基本情况

项目名称	半导体装备精密结构件建设项目
项目建设主体	重庆渝莱昇精密科技有限公司
项目实施地点	重庆市巴南区
项目总投资	55,509.61 万元
募集资金投入	50,000.00 万元
项目资金来源	募集资金、自筹资金
项目建设期	24 个月

#### 2、项目建设内容

本项目通过租赁并改造生产厂房，购置加工设备、模具及专用设备、检测设备及配套设备，并引进生产技术及管理人员，进一步扩大半导体装备结构产品的生产能力，以满足市场需求，丰富产品结构，进一步落实公司战略。

### 3、项目建设必要性

#### （1）符合国家及地方政策导向，在我国半导体产业链自主可控上发挥重要作用

半导体产业作为信息技术产业的核心，是支撑经济社会高质量发展和保障国家安全的战略性、基础性与先导性产业，其自主可控发展已成为国家产业发展的重要战略方向。2025年10月，中共中央发布《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的建议》，指出“全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破”。

当前，我国半导体产业链在部分关键环节仍存在对外依赖，设备零部件的自主供应能力不足已成为制约产业发展的重要瓶颈。本项目聚焦半导体装备精密结构件的研发与生产，产品可广泛应用于半导体加工设备的核心配套领域，通过突破关键制造技术、扩大自主供应规模，能够有效填补国内相关领域的供给缺口，在我国半导体产业链构建自主可控、安全稳定的供应链体系上发挥重要作用，符合国家及重庆市产业政策导向和战略发展需求。

#### （2）抓住半导体装备国产化替代的市场机遇，完善产能布局

在全球半导体产业格局深度调整与国内相关战略加速落地的双重背景下，我国半导体装备国产化替代已进入关键攻坚阶段。从国内市场来看，半导体产业作为支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，在国家政策大力支持、国产芯片进口替代，以及人工智能、无人驾驶、可穿戴设备等新兴产业需求增长的驱动下，已迎来全面发展的历史机遇。

长期以来，国内半导体设备市场对海外供应商存在较高依赖，核心设备及配套零部件的外部依存度较高，而半导体设备作为产业关键支撑环节，其国产化进程相对滞后于市场发展需求，已成为制约我国半导体产业高质量发展的突出瓶颈，产业链供应链安全面临潜在风险。尤其在当前国际竞争形势下，中美

贸易紧张局势加剧叠加半导体产业升级关键关口，加速推动半导体设备国产化进程，更承载着改变我国在全球半导体产业领域发展局面的重要使命。近年来，随着国家层面产业扶持政策持续加码、国内设备制造企业技术研发不断突破，以及下游芯片制造产业产能扩张需求日益迫切，半导体装备国产化进程显著提速。国内半导体设备厂商在快速崛起过程中，为进一步缩短产品交付周期、优化采购成本结构、规避地缘政治带来的供应链风险，对本土零部件供应商的采购意愿和合作深度持续提升，这为本土半导体设备零部件企业提供了广阔的发展机遇。

公司深刻洞察半导体装备国产化替代的市场机遇，较早启动半导体设备精密结构件业务的战略布局。经过前期技术攻关和市场拓展，凭借稳定的产品性能与可靠的质量控制，公司已顺利通过国内多家头部半导体设备厂商的合格供应商认证，建立了良好的合作基础与市场口碑。但随着下游客户产能扩张带来的订单需求持续增长，公司现有生产能力已难以满足客户交付要求，产能瓶颈问题日益突出，不仅延长了订单交付周期，更在一定程度上制约了公司市场份额的进一步提升。

本项目的实施正是公司应对产能瓶颈、把握国产化市场机遇的关键举措。通过新建专业化生产车间、引入先进生产及检测设备，公司将大幅提升半导体设备精密结构件的生产规模。通过本项目的实施，公司将加大对生产供应能力，以抓住市场机遇，快速抢占市场份额。

### **(3) 进一步拓展第二赛道，落实公司战略**

自成立以来，公司不断深耕铝合金精密压铸技术，已在汽车零部件、通信设备零部件等领域建立了稳固的市场地位。但单一业务赛道易受行业周期波动影响，为实现持续稳定发展，公司制定了“核心业务深耕+新兴业务拓展”的双轮驱动战略，明确将半导体业务作为第二增长曲线进行重点培育。

目前，公司在半导体领域已完成初步布局，通过前期研发投入与市场拓展，已掌握关键零部件的核心制造技术，实现了产品批量供货并与部分设备厂商建立了稳定合作关系，为半导体业务的进一步发展奠定了基础。

本项目的建设，是对公司第二赛道拓展战略的具体落实，通过扩大产能、

完善生产体系、提升技术研发能力，将推动公司半导体业务从初步布局向规模化、专业化发展转型，实现与其他业务的协同发展，降低单一业务波动对公司经营的影响，增强公司整体抗风险能力与可持续发展能力。

#### 4、项目建设可行性

##### （1）快速增长的市场需求，为本项目顺利实施提供市场保障

近年来，全球半导体产业保持稳步增长态势，处于景气发展周期。数字化进程加速和新产品迭代更新，成为半导体行业持续增长的内生因素；而下游物联网、人工智能、云计算、大数据、新能源汽车等新兴产业的强劲市场需求，构成推动半导体产业发展的外在核心驱动力。在此背景下，全球半导体产业链晶圆制造、封装及测试等各环节所需专用设备市场规模迅速扩大，半导体设备的更新换代速度随芯片制程不断升级、晶圆尺寸扩大以及新兴应用场景持续涌现而进一步加快，直接带动设备核心零部件的需求持续增长。

作为全球最大的半导体消费市场，我国近年来集成电路产业投资规模不断扩大，半导体设备国产化率逐步提升，进一步推动国内半导体设备市场规模快速增长。根据国海证券数据显示，2024年中国半导体设备销售规模达495.5亿美元，增长35.38%，中国已成为全球第一大半导体设备市场。

半导体设备精密结构件作为设备核心组成部分，直接影响设备的运行精度、稳定性和使用寿命，下游客户对产品的精度控制、材料性能、可靠性等方面具有严苛要求，产品附加值较高。未来，随着AI、新能源汽车等下游应用需求的持续释放，我国半导体产业将保持快速增长态势，半导体装备市场规模也将随之同步扩张，这为国内半导体设备零部件供应商提供了广阔的市场发展空间。

综上，公司凭借在精密制造领域的技术积累和前期市场开拓，已与多家半导体设备厂商建立合作关系，产品获得客户认可。随着国产化替代进程的深入，下游客户对国内零部件供应商的需求将持续增加，为项目产能消化提供了坚实的市场基础，为本项目提供广阔的市场前景和充足的需求保障

##### （2）深厚的技术储备为本项目顺利实施提供技术保障

通过在精密制造领域拥有二十多年的技术积累，公司在铝合金压铸、精密机械加工、表面处理、模具设计与制造等核心工艺上形成了成熟的技术体系，

具备高精度、高稳定性的产品制造能力。公司拥有一支经验丰富的研发团队，核心研发人员均具备多年行业从业经历，对精密制造工艺的研发与创新具有深刻理解。

在半导体设备精密结构件领域，公司通过前期研发投入与技术攻关，已突破部分关键制造技术，掌握了半导体设备用精密结构件的核心加工工艺，包括高精度尺寸控制、复杂曲面加工、特种表面处理等，能够满足半导体设备对零部件在精度、可靠性、耐腐蚀性等方面的要求。

此外，公司建立了完善的研发管理体系，形成了“市场需求-技术研发-中试验证-批量生产”的全流程研发机制，能够快速响应客户的个性化技术需求。同时，公司与国内多家科研院校及行业技术机构保持合作，持续引进先进技术与理念，为项目的技术实施提供了充足保障。

综上，公司现有的技术积累、研发能力及研发体系能够支撑本项目的顺利实施。

### **(3) 优质的客户资源为本项目市场拓展奠定坚实基础**

公司全力打造优质服务体系，及时与客户沟通产品需求信息、解决客户反映的问题，保证客户需求响应的及时性，凭借公司良好的品牌形象和业内口碑，公司已形成较为稳定的客户资源。多年来，公司始终专注于精密结构件压铸领域，已在业内形成了一定的口碑和行业地位。通过前期的技术研发和客户验证，公司已与深圳、上海等半导体设备厂商建立了合作关系。

公司始终关注并研究下游客户所处行业的发展动向和行业政策，根据客户的产品规划同步供应新产品，为大客户配备专门的技术研发、产品开发及制造团队，更好地服务大客户，以便能快速响应客户的发展需要。

公司优质的客户资源以及多年形成的服务能力，为本项目的产能消化提供了坚实保障。

## **5、项目投资概算**

本项目总投资55,509.61万元，其中募集资金投入50,000.00万元，具体资金投资计划如下表所示：

序号	投资内容	投资金融	拟使用募集资金额
一	建设投资	53,441.05	50,000.00
1	场地投入	1,845.36	-
2	设备投入	48,963.00	48,000.00
3	基本预备费	2,632.69	2,000.00
二	铺底流动资金	2,068.56	-
三	项目投资总额	55,509.61	50,000.00

## 6、项目经济效益分析

本项目有助于公司在现有通信、汽车领域精密压铸件产品基础上，扩充各类半导体设备精密结构件等产品线，实现产品结构向半导体高端制造配套领域的延伸，预计可为公司带来可观的经济效益，对公司发展有较好的促进作用。

## 7、项目涉及的有关报批事项

截至本预案公告日，本项目备案、环境影响评价等手续尚在办理中。

### （二）通信汽车零部件可钎焊压铸产业化项目

#### 1、项目基本情况

项目名称	通信汽车零部件可钎焊压铸产业化项目
项目建设主体	重庆綦美智能科技有限公司
项目实施地点	重庆市綦江区
项目总投资	52,449.96 万元
募集资金投入	50,000.00 万元
项目资金来源	募集资金、自筹资金
项目建设期	24 个月

#### 2、项目建设内容

项目拟通过租赁生产厂房，购置生产加工设备、检测设备及配套设备，建设可钎焊压铸件生产线。通过本项目的实施，公司将重点配套核心客户，满足市场需求，顺应市场趋势，以完善热管理产品矩阵。

#### 3、项目建设必要性

## （1）契合国家政策导向，助力通信及汽车领域热管理

5G通信、新能源汽车产业作为支撑经济社会高质量发展的战略性新兴产业，其核心技术突破与规模化应用已成为国家产业发展的重要战略方向，而可钎焊压铸零部件凭借优异的导热性能、结构集成度及轻量化优势是保障以上两大产业技术升级的热管理系统。国家及地方层面相继推出一系列产业政策，推动上述领域健康发展。

国家层面，2025年10月，中国汽车工程学会发布《节能与新能源汽车技术路图3.0》，明确提出“车路云一体化智能网联汽车基础设施生态体系成熟健全，高级别自动驾驶汽车产品实现大规模应用”；2024年12月，工业和信息化部等12部门联合印发《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》，明确提出“构建5G-A产业链，持续推进上下行超宽带、通感一体、无源物联、高精度低功耗定位、网络智能等关键技术研发试验，加快推进基站、核心网、终端、芯片和仪器仪表等设备研发及产业化”；2021年12月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，明确提出：“推动5G商用部署和规模应用，前瞻布局第六代移动通信（6G）网络技术储备”、“完善5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系”；2020年10月，国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出要推动新能源汽车基础核心零部件、关键基础材料等研发能力的提升，提高新能源汽车整车综合性能。

重庆市级层面，2022年3月，重庆市政府发布《重庆市战略性新兴产业发展“十四五”规划（2021—2025年）》，指出“在集成电路、新型显示、工业互联网、卫星互联网、5G、先进材料等领域推动创建一批国家级产业集群。大力推动新型智能终端、新能源汽车和智能汽车等产业集群发展”；2023年9月，重庆市委办公厅、重庆市政府办公厅发布《深入推进新时代新征程新重庆制造业高质量发展行动方案（2023—2027年）》，提出要“构建国内最为完整的智能网联新能源汽车零部件配套体系”、“带动低成本卫星、卫星高集成度系统、通信芯片、通信模组等环节发展，延展产业链条”。

当前，我国5G-A通信基站正进入规模化建设阶段，新能源汽车快充技术加速普及，智能驾驶传感器精度要求持续提升，三大领域均面临核心部件功率密度提升带来的热管理瓶颈，而高品质可钎焊压铸散热部件的自主供应能力不足

已成为制约产业升级的重要因素。本项目聚焦通信及汽车零部件钎焊压铸产业化，产品可广泛应用于5G-A基站高功率模块、新能源汽车电池包及智能驾驶智算平台等核心场景，通过突破精密压铸、钎焊工艺等关键技术，扩大高品质产品供应规模，能够有效填补国内相关领域的供给缺口，在保障5G通信与新能源汽车产业供应链稳定、推动热管理技术升级上发挥重要作用，符合国家及重庆市产业政策导向和战略发展需求。

### **(2) 满足市场需求，扩大产品供应能力**

随着新能源汽车与通信基站行业的持续扩张，叠加智驾领域的快速崛起，市场对高品质热管理产品的需求呈现快速增长的态势。

在新能源汽车领域，动力电池向高能量密度、高充电倍率的技术升级，使得电池热管理成为保障整车安全与性能的核心环节，流道板作为电池液冷系统的关键部件，市场需求持续攀升。在智驾领域，DMC智驾计算平台算力持续升级，高算力带来的高热流密度问题催生了对高效液冷散热产品的迫切需求随着下游客户新能源车型产能的持续释放，其对上述新能源汽车领域的热管理产品的采购需求进一步增加，公司现有产能已无法及时响应客户的批量交付要求。

在通信领域，5G-A通信基站建设进入加速期，基站功率较前代显著提升，芯片发热量大幅增加，对散热总成的散热效率与稳定性提出更高要求，带动5G-A基站散热总成需求快速增长。

综上，公司在热管理领域的市场拓展持续取得突破，不断切入新的客户供应链体系，新增客户需求进一步加剧了产能紧张局面。若不能及时扩大产能，公司不仅将错失当前市场增长机遇，还可能因交付能力不足影响与现有客户的合作粘性。通过本项目的实施，将有效解决目前的产能瓶颈，扩大业务规模。

### **(3) 顺应行业发展趋势，配套重大客户需求**

从行业发展趋势来看，液冷技术凭借散热效率高、适配高功率场景、能耗低等突出优势，已成为热管理行业的主流发展方向。

在新能源汽车领域，随着动力电池技术的不断突破，风冷等传统散热方式已难以满足电池在复杂工况下的热管理需求，液冷系统因能实现更均匀、高效的温度控制，已成为新能源汽车电池热管理的标配方案；在通信领域，5G-A技

术的商用推动基站功率持续升级，芯片集成度不断提高，发热量显著增加，传统散热方案无法满足基站稳定运行需求，液冷散热总成成为解决这一问题的关键；在智驾领域，DMC等智驾计算平台作为智能驾驶的核心部件，算力水平快速提升，高算力运行产生的大量热量严重影响系统运行稳定性，液冷技术凭借高效的散热能力成为保障其可靠运行的核心支撑。综上，多重下游应用场景的需求驱动，推动液冷技术在散热管理领域的应用进一步普及，行业对高品质液冷热管理产品的需求空间持续扩大。

从重大客户需求来看，随着技术升级与产能扩张，公司核心客户对散热管理产品的供应能力与技术水平要求不断提高。在汽车领域，上汽等整车厂商为提升新能源汽车的安全性能与续航能力，对配套流道板的精度、散热效率及交付稳定性提出更为严格的标准，同时随着其新能源汽车产量的提升，对流道板的采购规模持续扩大；在通信领域，诺基亚、爱立信、三星等全球知名电信设备厂商，以及行业内其他头部电信设备厂商，为保障5G-A基站的性能与稳定性，对散热总成的技术指标与产能保障能力提出更高要求，且随着其全球5G-A基站布局的推进，对散热总成的采购需求持续增长。

公司高度重视技术研发与迭代，紧跟行业技术发展方向，在液冷散热领域已形成成熟的技术体系，可钎焊压铸与散热融合产品技术水平处于行业领先地位，能够充分满足核心客户的技术升级需求。但受限于现有产能规模，公司无法完全匹配核心客户的增量订单需求，在一定程度上制约了与重大客户合作的深度与广度。

通过本项目建设，公司可大幅提升液冷散热产品产能，更好地承接重大客户的批量订单，满足其技术升级与产能扩张需求，进一步巩固与核心客户的长期合作关系。

#### 4、项目建设可行性

##### （1）公司具有成熟的技术成果和完善的研发管理体系

公司在散热管理产品领域已形成覆盖材料、工艺的完整技术体系，核心技术已成熟。

在材料配方方面，公司深耕高导热和轻量化材料研发，既通过精准元素配

比自主研发高导热铝合金，兼顾高导热系数与结构强度，满足液冷散热产品对材料性能的双重需求；同时，公司针对钎焊工艺需求开发专用合金，该合金参考国际领先耐高温合金技术，突破普通压铸合金难以适配钎焊工艺的局限，在机械与物理性能上更具优势且成本更低。

在压铸工艺方面，公司掌握高真空压铸核心技术，能有效减少压铸件气孔、降低含气量，既解决了传统压铸因含气量高导致的钎焊失效行业难题，又显著提升产品气密性与导热性能；同时针对新一代通信基站散热管理的复杂场景，开发高薄散热翅片压铸工艺，实现薄壁翅片一次成型，其尺寸精度与生产良率处于较高水平。

在压铸与钎焊结合工艺上，公司自主突破并开发液冷可钎焊压铸技术。该技术融合特种高温铝合金设计、超高真空压铸控制与特种装备，攻克压铸件表面氧化层阻碍焊接的行业难题，实现“不可钎焊”压铸铝合金零件与其他材料的高强度钎焊连接。公司将其应用于3D两相液冷结构后，通过冷媒封闭循环实现高效散热，同时让产品具备轻量化、结构紧凑、成本更低的特点，为高算力需求提供散热保障。该技术解决了传统焊接强度低、变形大的问题，使产品拥有焊接强度高、壁面薄、复杂型面成形性好的优势，公司是业内较早实现该技术规模化量产的企业之一。

此外，公司成立新技术研究院，与上海交通大学、同济大学等国内顶尖科研院校共建热管理及材料联合实验室，形成“需求洞察-技术攻关-场景落地”的全链路研发模式，持续推动散热管理技术迭代，进一步完善了公司的研发管理体系。

综上，公司较为成熟的技术和完善的研发管理体系为本项目顺利实施提供技术保障。

## **（2）公司具有优质的客户资源和完善的客户服务体系**

凭借领先的技术实力与完善的服务体系，公司已积累覆盖多领域的优质客户群体。公司已与上汽、蔚来、小鹏等知名车企，及与诺基亚、爱立信、三星等全球知名电信设备厂商建立稳定合作关系。

此外，公司建立完善的客户服务体系，为核心客户配备专属服务团队与驻

场工程师，实现需求响应、技术对接、交付协调的全流程跟进；针对客户全球化布局需求，在海外设立服务网点，提供及时的技术支持；针对同步开发需求，压缩研发周期，提升客户合作粘性。

优质的客户资源与扎实的合作基础，为项目投产后的销售提供有力保障。

### **(3) 公司具有完备的管理体系和丰富的生产经验**

公司经过多年发展，已建立完善的生产管理体系，积累了丰富的规模化生产经验，能够保障项目的顺利实施与高效运营。

在生产管理体系方面，公司通过ISO9001质量管理体系、IATF16949汽车行业质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证，构建从原材料采购到成品交付的全流程质量控制体系。采购环节实行合格供应商名录管理，对原材料进行严格检验，确保原材料质量稳定；生产环节采用MES系统实现生产过程实时监控，关键工序设置全检节点，产品不良率控制在较低水平；交付环节建立智能化仓储与物流体系，保障订单响应速度与交付准时率，报告期内交付准时率保持高位。

在生产经验方面，公司已在重庆、襄阳、东莞、马鞍山建立了生产基地，具备散热管理产品规模化量产能力，并配备行业先进的精密压铸机、全自动钎焊生产线、五轴加工中心等设备，设备自动化率较高。通过多年生产实践，培养了一支经验丰富的生产管理团队，核心管理人员拥有10年以上精密结构件生产管理经验，能够熟练应对多品类、大批量的生产组织需求，可快速实现新项目产能爬坡与稳定生产。

公司已积累的完善的生产管理体系和生产经验，为本项目顺利实施提供管理基础。

## **5、项目投资概算**

本项目总投资52,449.96万元，其中募集资金投入50,000.00万元，具体资金投资计划如下表所示：

序号	投资内容	投资金额	拟使用募集资金额
----	------	------	----------

<b>一</b>	<b>建设投资</b>	<b>50,141.61</b>	<b>50,000.00</b>
1	场地投入	5,000.00	5,000.00
2	设备投入	42,515.82	42,515.82
3	基本预备费	2,625.79	2,484.18
<b>二</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>2,308.35</b>	<b>-</b>
<b>三</b>	<b>项目投资总额</b>	<b>52,449.96</b>	<b>50,000.00</b>

## 6、项目经济效益分析

本项目有助于公司抓住新能源汽车、通信、智驾领域的发展机遇，进一步完善散热产品矩阵，以实现“全生命周期热管理解决方案”的业务布局战略，具有良好的经济效益，对公司发展有较好的促进作用。

## 7、项目涉及的有关报批事项

截至本预案公告日，本项目备案、环境影响评价等手续尚在办理中。

### （三）补充流动资金项目

#### 1、项目基本情况

公司拟将本次向特定对象发行A股股票募集资金中20,000.00万元用于补充流动资金。

#### 2、项目的必要性

##### （1）公司业务快速发展，营运资金需求日益加大

受益于新能源汽车以及5G通信等下游行业的快速发展和公司综合竞争实力的持续提升，公司经营规模稳步扩大。2022年、2023年、2024年和2025年1-9月，公司分别实现营业收入317,004.32万元、318,914.66万元、365,898.22万元和281,991.51万元。公司在业务规模迅速扩大的同时也面临着持续性的营运资金压力，营运资金不足将成为制约公司进一步发展的重要因素。

本次通过向特定对象发行股票募集资金补充流动资金，可在一定程度上缓解公司因业务规模扩张而产生的资金压力，保障公司业务发展，增强公司总体竞争力。

##### （2）减少财务费用，提升财务稳健性水平

为了扩大生产经营，公司近些年新建募投项目、安徽工厂和美国工厂，固定资产投资规模增加，带动整体负债规模提升。2022年末、2023年末、2024年末和2025年9月末，公司资产负债率分别为68.43%、42.65%、56.76%和 62.19%，资产负债率有所上升，导致偿债压力上升。公司负债中流动负债占比较高，短期借款等流动负债易受到宏观经济环境、国家信贷金融政策、行业发展形势以及企业基本面等因素影响而产生波动，从而增加公司的流动性风险。较高的有息负债水平导致公司利息支出长期处于较高水平。通过本次发行补充流动资金，将有效缓解公司资金压力，减少短期负债规模，降低利息支出，提升财务稳健性水平。

### **3、项目的可行性**

#### **(1) 本次向特定对象发行A股股票募集资金使用符合法律法规的规定**

公司本次向特定对象发行股票的募集资金用于补充流动资金符合相关政策和法律法规的规定，符合公司当前的实际发展情况，具有可行性。

本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加，资产负债率将有所降低，有利于改善公司资本结构，从而提升盈利水平，促进公司长期可持续发展，符合公司及全体股东利益。

#### **(2) 公司具备完善的法人治理结构和内部控制体系**

公司已按照上市公司的治理标准，建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进与完善，形成了较为规范、标准的公司治理体系和较为完善的内部控制环境。

公司在募集资金管理方面按照监管要求，建立了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向以及监督等方面作出了明确规定。本次向特定对象发行股票募集资金到位之后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储与使用，从而保证募集资金规范合理的使用，降低募集资金使用风险。

### **三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响**

#### **(一) 本次发行对公司经营管理的影响**

本次募集资金扣除发行费用后，用于半导体装备精密结构件建设项目、通

信汽车零部件可钎焊压铸产业化项目以及补充公司流动资金，将为公司业务发展提供资金保障，并有效缓解公司日常经营活动的资金压力。本次募集资金投资项目均为围绕公司主营业务开展，募集资金项目顺利实施后，公司的技术水平和服务能力将得到有效优化，从而能够更好地满足市场和客户的需求。

## （二）本次发行对公司财务状况的影响

本次募集资金投资项目具有良好的市场前景、经济效益和社会效益。募集资金到位后，公司总资产和净资产规模将相应增加，能够为公司发展提供资金保障。由于募集资金投资项目建设完成并逐步释放效益需要一段时间，短期内不会产生效益或效益较低；未来，随着项目的运营实施，公司的经营规模和盈利水平将进一步提升，财务状况得到进一步改善，最终将会推动公司的业务规模和盈利能力进一步提升。

## （三）本次发行对公司现金流量的影响

本次发行完成后，募集资金到位将使得公司筹资活动产生的现金流入增加。随着募集资金投资项目的逐步实施，投资活动现金流出也将相应增加，在募投项目完成并实现效益后，公司收入规模和利润水平预计将逐步提高，公司未来经营活动现金流入也将随之增加。总体来看，本次发行有助于改善公司现金流量状况，降低经营风险。

## 四、本次募集资金使用的可行性分析结论

综上所述，公司本次向特定对象发行股票募集资金投向符合国家产业政策及行业发展趋势，与目前上市公司的主营业务紧密相关，符合公司未来发展的战略规划。公司本次向特定对象发行股票募集的资金拟通过向子公司增资或委托贷款等形式支持其开展半导体装备精密结构件建设项目、通信汽车零部件可钎焊压铸产业化项目，在此基础上实现半导体装备精密结构件等领域的应用布局以及通信及汽车零部件可钎焊压铸产业化，具有良好的市场前景和经济效益。公司本次向特定对象发行股票募集的部分资金用于补充公司流动资金，有利于降低财务风险，提高偿债能力、后续融资能力和抗风险能力，推动公司持续稳定发展。上述项目的实施将为公司经营带来有力的支持，是公司在业务布局、研发能力、财务能力、长期战略等多个方面夯实可持续发展的基础，有利于增强公司核心竞争力，持续提升盈利能力，符合公司及全体股东的利益，并创造

更多的经济效益与社会价值。因此，本次向特定对象发行股票募集资金使用具有必要性和可行性。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日